

関係各位

レンゴー株式会社
広報部広報課

「エコプロ 2018」出展のご案内

レンゴー株式会社（本社：大阪市北区、会長兼社長：大坪 清）は、今年も「エコプロ 2018 SDG s時代の環境と社会、そして未来へ」に出展いたします。

当社ブースでは「段ボール博物館」をテーマに、より少ない資源で大きな価値を生む、当社の製品づくりのキーワード“Less is more.”を体現するパッケージのcazucazuをご紹介します。

是非ご来場のうえ、当社ブースへお立ち寄りいただきますようご案内申し上げます。

エコプロ 2018 概要

会 期 2018年12月6日(木)～8日(土) 10:00～17:00
会 場 東京ビッグサイト（東京国際展示場）
主 催 一般社団法人産業環境管理協会、日本経済新聞社
当社ブース 東6ホール 6-021



レンゴーブースの主な展示内容

- ・段ボールの優れた特徴とリサイクルの仕組み
- ・生分解性素材であるセルロース（ビスコース）関連製品
- ・開封が容易で店頭での品出し作業を効率化するリテールメイトシリーズ「レンゴー スマート・ディスプレイ・パッケージング（RSDP）」
- ・耐水、防炎、低摩擦など、さまざまな機能性段ボール
- ・段ボールベッドなどの防災関連製品



以上